CareerCross by JAC Recruitment

JAC Recruitment
グローバル企業・外資×ハイクラス転職
「語学力」を活かす転職なら、JAC Recruitment

半導体プロセス材料開発技術者

電子デバイス研究開発のご経験のある方は歓迎です。

募集職種

人材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名
非公開

求人ID
1488557

業種
電気・電子・半導体

雇用形態
正社員

勤務地
大阪府

給与
600万円 ~ 1000万円

勤務時間
08:30 〜 17:00

休日・休暇
【有給休暇】初年度 14日 3か月目から 完全週休2日制、夏季休暇、年末年始、慶弔、育児・介護休暇制度、有給休暇：年次有給22…

更新日
2025年04月10日 12:00

応募必要条件

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
ビジネス会話レベル

日本語レベル
ネイティブ

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2238902】
新たな成長フェーズに入った半導体市場で微細加工プロセスや三次元積層における材料開発に携わっていただきます。具体的には微細配線や3D NAND用絶縁膜を形成するための製膜剤（プリカーサー）開発や、そのプリカーサーを用いたCVD/ALDによる薄膜形成プロセス開発/評価、三次元積層に関連するプロセス技術などを検討して頂き、最終的には顧客提案や学会＆コンソーシアでの対外連携へとつなげていきたいと考えています。

■ポジション・立場：技術開発中核メンバー/リーダー層

スキル・資格

【必須】
・半導体薄膜工程プロセス用有機・無機材料開発を行ってきた開発経験者
・プロセス設計（成膜評価/信頼性評価 等）の開発経験者
・経験年数：5年程度
・英語：簡単なメールの作成が可能 （目安としてTOEIC500点程度以上）
・英語：或る程度日常会話が可能（目安としてTOEIC700点

■専攻学科
工学系

≪求める人物像≫
半導体プロセス開発やプリカーサーの設計、3D積層に関する専門的な知識をプロセス開発や材料開発に落し込み、提案・具体化し、実行できる方。また、展示会、学会など技術動向を理解できる方。

≪業界・企業・職種≫
薄膜材料メーカーや半導体製造メーカーで材料開発に携わった経験者
装置メーカーでのプロセス開発に携わった経験者

≪キーワード≫
半導体、製膜剤（プリカーサー）、CVD、ALD、三次元積層

会社説明

ご紹介時にご案内いたします